



# 电子行业研究

**买入（维持评级）**
**行业周报**  
 证券研究报告

电子组  
 分析师：樊志远（执业 S1130518070003）  
 fanzhiyuan@gjzq.com.cn

## 北美 CSP 厂商加码 AI 投入，大模型成本下降助力 AI 应用崛起

### 电子周观点：

**北美 CSP 厂商加码 AI 投入，大模型成本下降助力 AI 应用崛起。**谷歌、亚马逊、Meta 公布资本开支指引，谷歌计划在 2025 年投资 750 亿美元用于资本支出，高于市场预期的 588 亿美元。公司预计 2025 年第一季度的资本支出将在 160 亿至 180 亿美元之间，同样高于市场预期的 143 亿美元。亚马逊第四季度资本支出为 278 亿美元，远高于分析师预期的 223 亿美元，创历史新高，2025 年的资本支出预计将达到 1050 亿美元，表明正在加大支出支持 AI 业务发展。Meta 预计 2025 年资本开支为 600~650 亿美元，同比大幅增长，主要用于生成式 AI 与公司的核心业务，同时大幅发展人工智能团队，公司认为目前推理端要求更高质量的服务，推理端算力需求持续提升。我们认为低成本高性能模型的出现，有望大幅降低垂类模型、行业模型微调成本，加大各类企业客户构建自己模型，同时有望大幅度降低 AI 应用成本，助力 AI 应用铺开。另外对于最尖端模型，北美大厂仍在继续加码探索，训练算力需求依然旺盛。在 AI 赋能下，AI 眼镜已经出现了多点开花的情况，Meta Ray-Ban 接入大模型后，销量率先爆发，2025 年 CES 展上，AI 眼镜精彩纷呈，除了智能眼镜外，智能手机接入 AI 后销量也出现了积极带动，苹果 CEO 库克表示，iPhone 16 机型在已经推出 Apple Intelligence 功能的市场中销量更好，从写作工具到图像生成技术，再到视觉智能、AI 消除等，这些功能都很受用户欢迎。我们认为，iPhone 成效初显，4 月 Apple Intelligence 将适配更多语言，随着 AI 端侧及云端的不断升级，将带来积极的换机需求。除了 AI 眼镜、AI 手机外，AI PC、机器人、电子狗、AI 玩具、AIOT 设备也有望快速增长，AI 大模型在端侧的应用多点开花，整体来看，AI 算力硬件需求持续旺盛，苹果 SE4 有望 3 月发布，AI 眼镜需求爆发，AIOT 设备应用崛起，继续看好苹果链、AI 智能眼镜、AI 驱动及自主可控产业链。

**细分赛道：**1) 半导体代工：2025 年台积电 CoWoS 月产能将增至 6.5-7.5 万片晶圆，2026 年月产能将达到 9-11 万片。2) 消费电子：根据 IDC 数据，2024 全年智能手机出货量达到 12.4 亿部，同比增长 6.4%，24Q4 全球智能手机出货量 3.317 亿部，同比增长 2.4%，连续第六个季度保持增长。3) PCB：从 PCB 产业链 12 月最新数据来看，整个行业景气度维稳，上游景气度回暖更明显、同环比均有明显提升，整个景气度判断为“稳健向上”。根据我们产业链跟踪，主要原因来自于家电、消费类随着政策补贴加持而景气度向上。4) 元件：AI 带动被动元件产品升级，LCD 面板价格启动涨价。5) IC 设计：Deepseek 低成本国产模型性能强劲，看好 AI 应用爆发拉动半导体的需求。6) 半导体代工、设备、材料、零部件：制裁密集落地，产业链持续逆全球化，自主可控逻辑继续加强。

### 投资建议与估值

Meta、谷歌、亚马逊 2025 年资本开支指引超预期，对于最尖端模型，北美大厂仍在继续加码探索，训练算力需求依然旺盛；英伟达 GB200 良率积极提升，有望在 3 月的 GTC 大会推出 GB300 服务器及新产品、技术路线图，算力硬件高景气持续；我们从产业链了解到 AI-PCB 需求持续旺盛，一方面是英伟达 AI 服务器需求强劲，CSP 厂商自研 ASIC 芯片服务器爆发，此外还有 800G 交换机需求大幅提升，PCB 也随之量价齐升，继续看好 AI-PCB 核心受益公司。苹果 iPhone 16 机型在已经推出 Apple Intelligence 功能的市场中销量更好，并在 4 月适配更多语言，有望在 3 月发布 SE4 机型，苹果链核心受益公司 Q1 业绩有望高增长；我们认为 AI 端侧应用正在加速，有望给智能眼镜、TWS 耳机、可穿戴及手机/PC 等 IOT 硬件产品带来创新和新的机遇。继续看好苹果链、AI 智能眼镜、AI 驱动及自主可控受益产业链。

### 风险提示

需求恢复不及预期的风险；AIGC 进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险。



## 一、细分板块观点

### 1.1 消费电子：2024 年全球手机出货量同增 6.4%，AI 边端未来可期

从总量来看，根据 IDC 数据，2024 全年智能手机出货量达到 12.4 亿部，同比增长 6.4%，24Q4 全球智能手机出货量 3.317 亿部，同比增长 2.4%，连续第六个季度保持增长。分品牌来看，前两大品牌苹果、三星在 2024 年总销量同比下滑，小米排名第三，是 2024 年是前五名厂商中同比增长率最高的，同增 15.4%，传音排名第四，同增 12.7%，主要受益于低端和中端产品的市场开拓。

Deepseek 通过平衡性能、内存占用和推理速度实现低成本、高效率，低成本高性能模型有望带动推理应用爆发，催化更多推理端需求，有利于 AI 硬件端的落地与普及，未来搭载语音大模型的 AI 手机、AI 眼镜等端侧产品有望具备更良好使用体验，端侧 IoT 及消费电子设备有望百花齐放，吸引更多客户需求。同时 AI 助手、AI 感情陪护等端侧 AI 应用有望更加智能化，带动终端新增需求以及换机需求。

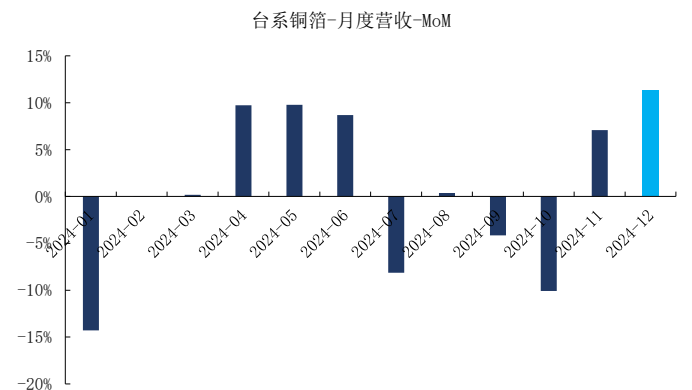
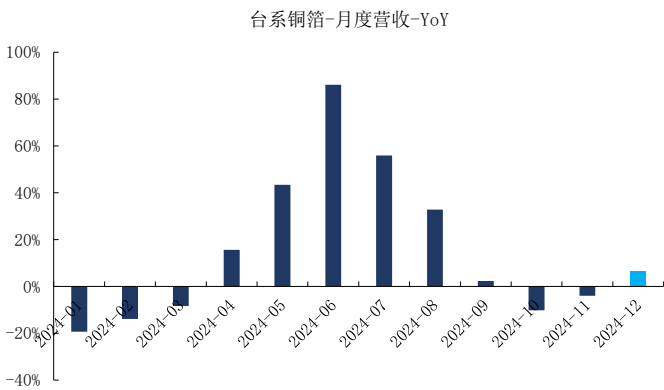
1 月 15 日，商务部发布《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》，明确指出了新的补贴标准。个人消费者购买手机、平板、智能手表（手环）3 类数码产品（单件销售价格不超过 6000 元），可享受购新补贴。每人每类可补贴 1 件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的 15%，每件最高不超过 500 元。之前有十四个省或省内部分城市实施了消费电子补贴政策，而此次补贴方案将从 1 月 20 号开始在全国实行，刺激补贴方案将会刺激消费电子产品 2025 年市场复苏。

### 1.2 PCB：1 月延续景气度回暖，下游 PCB/CCL 维稳

从 PCB 产业链 12 月最新数据来看，整个行业景气度维稳，上游景气度回暖更明显、同环比均有明显提升，整个景气度判断为“稳健向上”。根据我们产业链跟踪，主要原因来自于家电、消费类随着政策补贴加持而景气度向上。

图表1：台系电子铜箔厂商月度营收同比增速

图表2：台系电子铜箔厂商月度营收环比增速

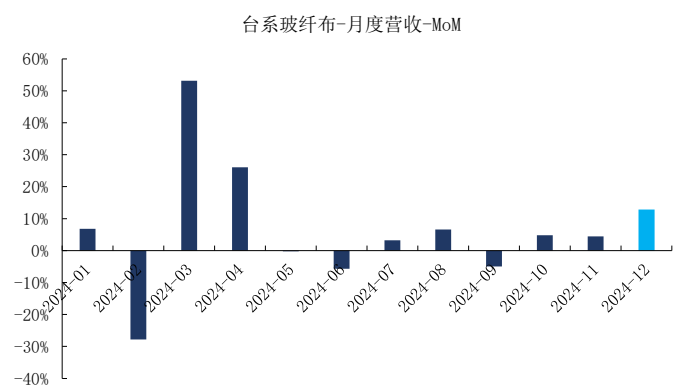
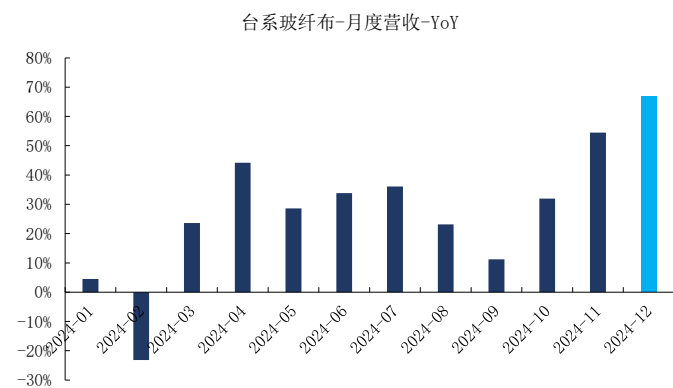


来源：Wind，国金证券研究所

来源：Wind，国金证券研究所

图表3：台系电子玻纤布厂商月度营收同比增速

图表4：台系电子玻纤布厂商月度营收环比增速

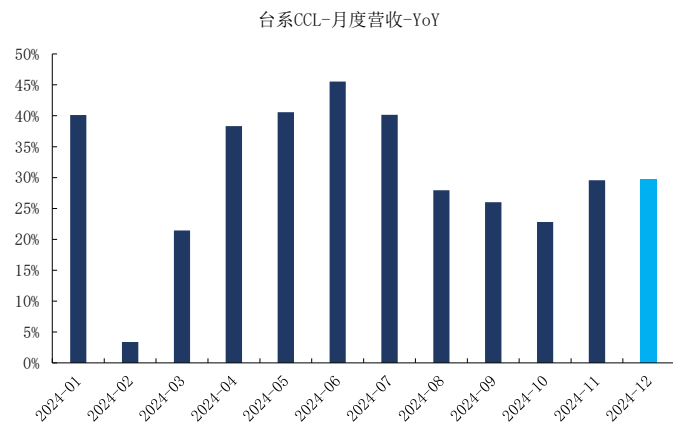


来源：Wind，国金证券研究所

来源：Wind，国金证券研究所

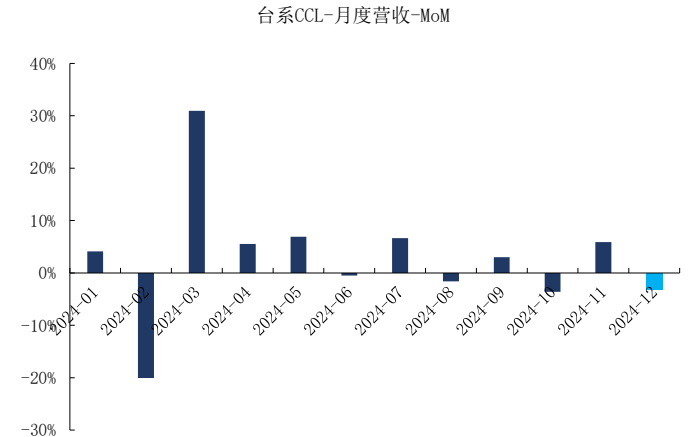


图表5: 台系覆铜板厂商月度营收同比增速



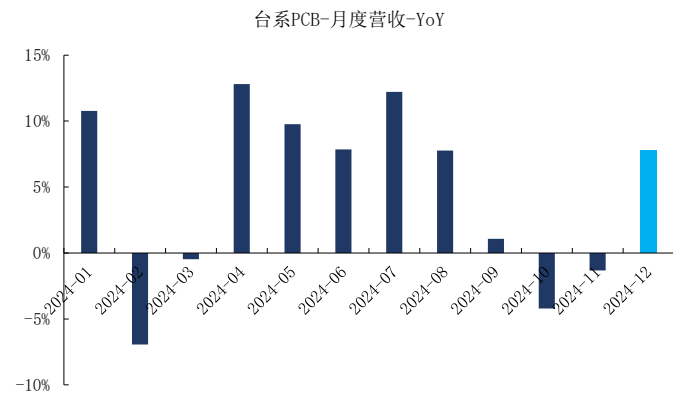
来源: Wind, 国金证券研究所

图表6: 台系覆铜板厂商月度营收环比增速



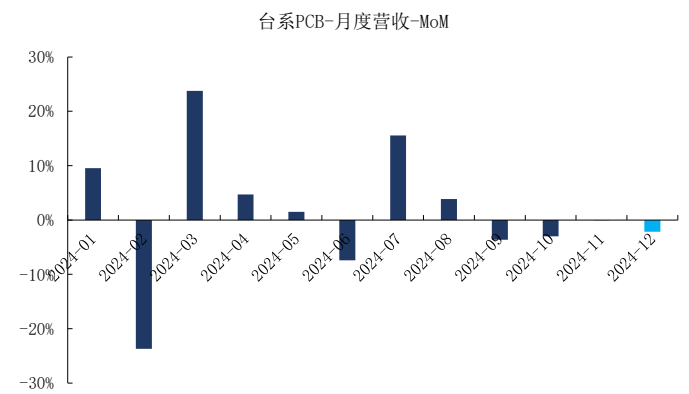
来源: Wind, 国金证券研究所

图表7: 台系PCB厂商月度营收同比增速



来源: Wind, 国金证券研究所

图表8: 台系PCB厂商月度营收环比增速



来源: Wind, 国金证券研究所

### 1.3 元件: AI 带动被动元件产品升级, LCD 面板价格启动涨价

#### 1) 被动元件: AI 带动被动元件产品升级

AI 服务器:以 GB200 系统主板为例,MLCC 总用量较通用服务器增加一倍,高容标准品单位用量高,1u 以上用量占 60%,X6S/X7S/X7R 耐高温用量高达 85%,系统主板 MLCC 总价也增加一倍。电感方面,H100、GB200 需要搭配芯片电感。超级电容品类。

AI 端侧:端侧手机对稳定供电和滤波方面的要求很高。AI 手机单机电感用量预计增长,价格提升;MLCC 手机用量增加,均价有提升,主要是产品升级(高容高压耐温、低损耗)。端侧笔电以 WoA 笔电(低能耗见长的精简指令集 RISC,ARM 设计架构)为例,ARM 架构下 MLCC 容值规格提高,其中 1u 以上 MLCC 用量占总用量近八成,每台 WoA 笔电 MLCC 总价大幅提高到 5.5~6.5 美金。

看好国产替代加速+AI 带来的升级。2022 年起需求较弱的背景下大陆企业国产替代进程放缓,稼动率恢复后迎来国产替代明显加速、个股阿尔法强弱分化(2024 年体现明显)阶段。产品升级方面,之前 5G 升级、AIot 升级、电动车发展带来的产品升级及估值拉动,本轮主要为 AI 带来的用量增加、产品性能升级。

下游景气度方面,2025 年预计将伴随着需求稳健好转,景气度持续向上,有基本面业绩支撑,增长斜率取决于宏观情况。需求端,展望 2025,AI 服务器、端侧需求旺盛,传统手机、笔电旺季订单相对保守,车载高景气度持续且价格情况改善,家电、工业预计平稳增长。

#### 2) 面板: LCD 面板价格有望启动涨价,京东方 8.6 带线 OLED 招标在即

LCD: 1) 根据 WitsView 最新面板报价,1 月上旬 32/43/55/65 吋面板价格上涨 1/1/0/2 美金,12 月超大尺寸已开始涨价,1 月上旬报价 65 吋以下也启动涨价,行业拐点积极信号持续释放。2) 需求情况:国补政策持续带动中国 TV 品牌厂采购需求,超大尺寸 TV 销售超预期,整体来看,国际品牌年底控管库存,需求动能平稳,国内品牌需求维持强劲,且供应链库存健康,1 月来看订单趋势持续向上。3) 供给情况:24Q4 淡季不淡稼动率超预期,25Q1 春节因素+动态控产,且超大尺寸需求旺盛产能面积消耗更大,预计后续面板厂仍将动态调控供给,带动价格上涨。



**OLED: 看好上游国产化机会。**国内 OLED 产能释放、高世代线规划带动上游设备材料厂商需求增长+国产替代加速。8.6 代线单线有机发光材料用量远高于 6 代线。有机发光材料技术壁垒高、海外专利垄断，设备端蒸镀机、掩膜版美日企业主导，国内供应商正在加速面板厂导入验证，目前 8.6 代线面板厂规划即三星、LG、京东方、维信诺，大陆话语权增强也在加速上游国产化进程。国内厂商加速下游面板厂配套合作、导入验证，建议关注奥来德、莱特光电、京东方 A、维信诺。

#### 1.4 IC 设计: 比亚迪即将召开智驾发布会, 重视车用芯片机会

2 月 6 日, 比亚迪官宣将于 2 月 10 日 19:30 在深圳总部召开智能化战略发布会。受益于 Deepseek 平价大模型的问世, 2025 年将成为 AI 应用的大年, 我们看好 AI 眼镜、机器人、智能驾驶有望成为 AI 应用率先落地的几个领域。比亚迪适时发布智驾系统, 我们认为这将进一步加快 AI 在自动驾驶系统的应用。同时, 此前中国汽车工业协会、中国半导体行业协会联合发布声明, 呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片, 这将进一步加快国产车用芯片的导入。我们持续车用芯片加速国产替代的机会, 建议重点关注: 1) 车用主控 Soc 芯片: 地平线、黑芝麻; 2) 车用 MCU: 比亚迪电子、兆易创新、国芯科技等; 3) 车用 serdes/以太网芯片: 龙迅股份、裕太微等; 4) 车用模拟: 纳芯微、思瑞浦等; 5) 车用 CIS: 韦尔股份、思特威等。

从投资领域, 半导体芯片产业强者恒强, 我们持续看好国内半导体芯片龙头, 建议关注: 1) 模拟芯片: 圣邦股份、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子、杰华特等; 2) MCU: 兆易创新、中颖电子、普冉股份、国民技术等; 3) CIS: 韦尔股份、思特威、格科微等; 4) SoC: 恒玄科技、晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微等; 5) 通信芯片: 盛科通信、裕太微、源杰科技等。

#### 1.5 半导体代工、设备、材料、零部件观点: 制裁密集落地, 产业链持续逆全球化, 自主可控逻辑继续加强

**半导体代工、设备、材料、零部件观点:** 半导体产业链逆全球化, 美日荷政府相继正式出台半导体制造设备出口管制措施, 半导体设备自主可控逻辑持续加强, 为国产半导体产业链逻辑主线。出口管制情况下国内设备、材料、零部件在下游加快验证导入, 产业链国产化加速。

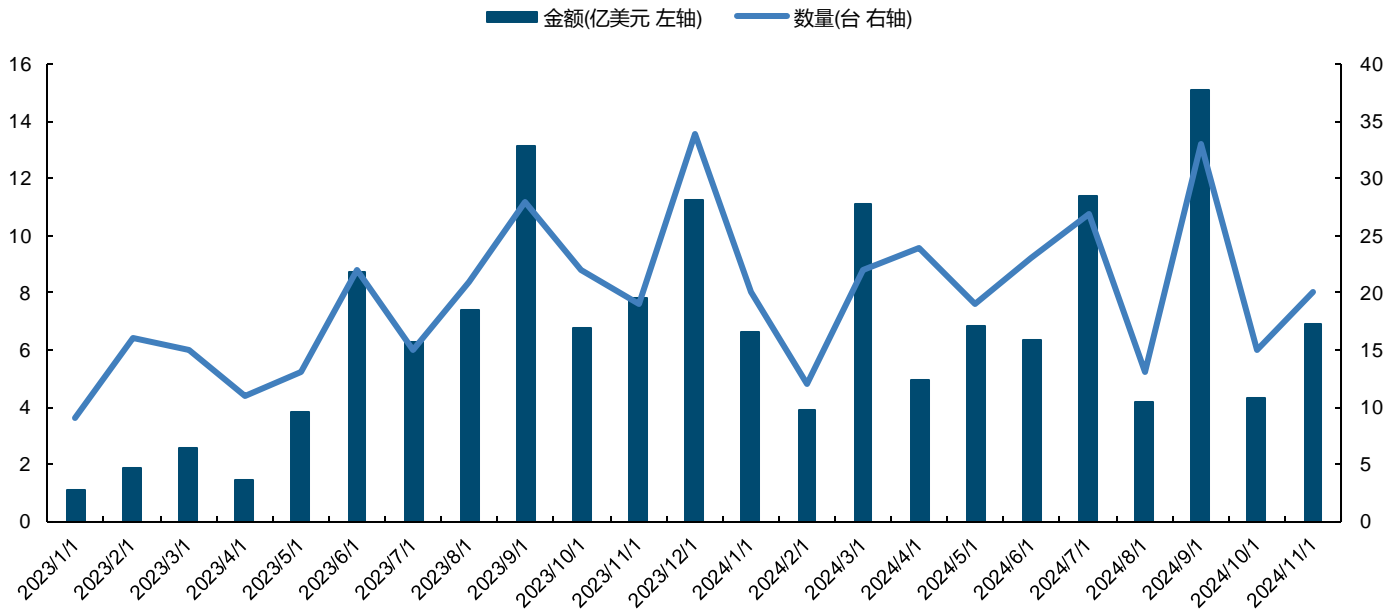
**封测:** 先进封装需求旺盛, 重视产业链投资机会。台积电在 4Q24 法说会上表示, 预计 25 年 CAPEX 为 38~42B 美元来支持未来的增长。38~42B 美元当中 70% 是先进制程的扩产, 10~20% 是特色工艺, 10~20% 是用于先进封装、测试、光罩等, 先进封装持续扩产。此外, 国产算力需求旺盛, 有望拉动国内先进封装产业链。算力需求旺盛, 地缘政治因素影响下, 算力端自主可控成为国产算力核心发展方向。寒武纪、华为昇腾等 AI 算力芯片需求旺盛, 先进封装产能紧缺, 持续扩产背景下先进封装产业链有望深度受益。此外, HBM 产能紧缺, 国产 HBM 已取得突破, 看好相关产业链标的。建议关注: 长电科技、甬矽电子、通富微电、利扬芯片、伟测科技; 封测设备及耗材: 华峰测控、金海通、和林微纳。

**半导体设备板块:** 半导体设备景气度加速向上, 根据 SEMI 2024 年 9 月 26 日最新发布的报告来看, 全球 300mm 晶圆厂扩产有望重回爆发式增长。全球范围内, 300mm (12 寸) 晶圆厂设备支出主要是由半导体晶圆厂的区域化以及数据中心和边缘设备中使用的人工智能 (AI) 芯片需求不断增长推动的。SEMI 预计将在 2024 年增长 4% 至 993 亿美元, 并在 2025 年进一步增长 24% 至 1232 亿美元, 首次超过 1000 亿美元, 预计 2026 年支出将增长 11% 至 1362 亿美元, 随后在 2027 年增长 3% 至 1408 亿美元。分区域来看, 中国是最大的下游市场, 2024 年中国半导体设备市场规模将达 450 亿美元, 未来三年将投资超过 1000 亿美元。根据 ASML 2025 年 1 月 29 日发布的 24Q4 财报数据来看, 光刻机需求持续旺盛, Q4 新签订单达 70.88 亿欧元, 环比+169%, 反应其旺盛需求。

2024 年 1-11 月中国从荷兰半导体设备进口金额同比大增, 反映了国内半导体产业持续扩张。根据中国海关总署的最新数据, 2024 年 1-11 月, 中国从荷兰的半导体设备进口额达到 81.75 亿美元, 同比增长 34%, 进口光刻机台数共计 228 台, 显示出国内半导体制造业对高端设备的强烈需求。光刻机已成功到位, 看好后续其他主设备陆续招标。



图表9：2024年1-11月从荷兰光刻机进口额达到81.75亿美元，同比增长33.97%



来源：海关总署，国金证券研究所

后续，我们看好国内存储大厂及先进制程扩产加速落地，建议关注订单弹性较大的【北方华创/拓荆科技/中微公司/华海清科/京仪装备】；另一方面消费电子补库，半导体需求端也在持续改善，随着周期走出底部，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，自主可控叠加复苏预期，我们持续看好设备板块。此外，部分国产化率较低设备 25 年或将有所突破，建议关注【芯源微/中科飞测/精测电子】。

半导体材料：看好稼动率回升后材料边际好转及自主可控国产化快速导入。材料相对后周期，行业β会受到一些半导体行业景气度的影响，三季报来看，材料端营收利润环比弱复苏。当前美国杜邦已经在逻辑和存储相应的制裁领域断供，日本加入了设备的制裁，材料风险也在增加。中长期看好平台化材料公司，短期看好光刻胶公司的催化机会，建议关注鼎龙股份、雅克科技，安集科技等。

## 二、重点公司

### 看好苹果链、AI 智能眼镜、Ai 驱动及自主可控受益产业链

Meta、谷歌、亚马逊 2025 年资本开支指引超预期，对于最尖端模型，北美大厂仍在继续加码探索，训练算力需求依然旺盛；英伟达 GB200 良率积极提升，有望在 3 月的 GTC 大会推出 GB300 服务器及新产品、技术路线图，算力硬件高景气持续；我们从产业链了解到 AI-PCB 需求持续旺盛，一方面是英伟达 Ai 服务器需求强劲，CSP 厂商自研 ASIC 芯片服务器爆发，此外还有 800G 交换机需求大幅提升，PCB 也随之量价齐升，继续看好 AI-PCB 核心受益公司。苹果 iPhone 16 机型在已经推出 Apple Intelligence 功能的市场中销量更好，并在 4 月适配更多语言，有望在 3 月发布 SE4 机型，苹果链核心受益公司 Q1 业绩有望高增长；我们认为 AI 端侧应用正在加速，有望给智能眼镜、TWS 耳机、可穿戴及手机/PC 等 IOT 硬件产品带来创新和新的机遇。继续看好苹果链、AI 智能眼镜、Ai 驱动及自主可控受益产业链。建议关注：生益科技、沪电股份、立讯精密、恒玄科技、瑞芯微、生益电子、鹏鼎控股、东山精密、水晶光电、蓝特光学、歌尔股份、胜宏科技、方正科技、蓝思科技、领益智造、传音控股、江丰电子、铂科新材、顺络电子、三环集团、东睦股份、北方华创、中微公司、长电科技、瑞可达。

立讯精密：Apple Intelligence 重新定义 AI 边端，2025 年苹果换机周期可期。①软件方面，Apple Intelligence 系统逐步上线升级，有助于带动新一波换机周期；硬件方面，2025 年苹果有望发布 iPhone 17 Slim，Slim 款可能是十年来最大的外观改款。②公司自 2020 年切入 iPhone 组装后、成为公司重要增长引擎。我们估算目前 iPhone 组装份额为 20%，预计未来伴随组装份额持续增长、利润率抬升，带动公司利润持续增长。③公司作为 Vision Pro 的 OEM 厂，未来有望深度受益产品放量周期。

沪电股份：高速通信类是保证公司成长的关键。公司高速通信产品主要用于交换机、服务器、运营商通信，客户覆盖包括国内外主要的设备商和云计算厂商，是 A 股 PCB 中涉及海外高速运算敞口最大的厂商，也是参与全球 AI 运算供应的关键厂商，未来有望随着 AI 市场扩容而实现快速增长。公司汽车类产品主要供应全球龙头 TIER1 厂商，并且依据多年的技术积累不断调整产品结构至覆盖多类域控制器用 HDI 产品，汽车智能化趋势将为公司带来成长贡献。

江丰电子：公司以溅射靶材业务为基础，战略布局半导体精密零组件助力产业链自主可控。海外对中国大陆半导体行业的限制范围持续扩大，国产设备加速验证导入，半导体设备和零部件持续受益国产替代。24Q3 公司回购股份彰显长



期发展信心。

**东睦股份：**公司是国内粉末冶金行业龙头企业，主要从事粉末压制成形（P&S）、软磁复合材料（SMC）和金属注射成形（MIM）三大业务，PS 业务为国内龙头，SMC 业务产能为全球第一梯队，MIM 应用于折叠屏手机等消费电子领域，深度绑定国内大客户。公司产业链上下游布局，三大业务多元协同发展。

**中际旭创：**公司作为全球第一梯队光模块供应商，下游深度绑定大客户。1.6T 光模块有望于 2025 年上量，根据公司公告，行业客户 2025 年 800G 需求指引相比于 2024 年大幅提升。1.6T 产品需求受 GB200 应用有望持续提升。硅光有望成为公司重要优势，公司已有 1.6T 硅光解决方案和自研硅光芯片，未来有望放量。

**生益电子：**公司是传统高速通信类覆铜板生产厂商，在服务器需要用到高多层板上具有深厚的技术积累，公司服务器类客户覆盖了国内主流客户群和海外部分客户，随着国内加大训练端算力需求、海外 AI 相关应用加速推出，公司服务器类 PCB 将迎来增长。

**天孚通信：**25 年需求清晰，海外云厂商在持续加大 AI 大模型以及 AI 数据网络硬件方面的投资。海外工厂进展顺利，800G/1.6T 光引擎需求释放叠加产能瓶颈逐渐缓解。随着人工智能 AI 技术的发展和算力需求增加，全球数据中心建设带动光器件产品需求持续稳定增长，叠加公司产能瓶颈缓解、产能利用率提升，公司经营状况有望持续提升。

**顺络电子：**公司持续多元化布局，汽车电子、光伏储能、云计算等新兴业务打开向上空间。Q3 单季度销售收入创历史新高，Q3 税前利润首次突破 3 亿，归母净利润为 2.56 亿元，环增 29.43%，同增 15.57%。汽车业务受益于国内诸多大客户在 BMS、功率共模器件、驱动变压器等产品上放量，同比高速增长，收入占比明显提升，手机、泛消费同环比保持增长。预计 2024-2026 年归母净利润为 8.68、11.42、14.34 亿元，同比+35.56%、+31.52%、+25.61%。

**Credo：**FY25Q2（24.8~24.10）营收创纪录，达 7203.4 万美元，同比+63.6%，环比+20.6%。公司迎来收入环比加速时刻，指引 FY25Q3 收入 1.15~1.25 亿美元，中枢环比增长 67%，GAAP 毛利率 60.6%~62.6%，Non-GAAP 毛利率 61.0%~63.0%。公司预期 FY25Q4 实现双位数环比增长，并预计 FY26 收入实现 50%左右的同比增长。除了原有头部云厂商以外，公司与 XAI 也进行深度合作。公司本季度有三家客户收入占比超过 10%，其中微软收入占比达到 11%，公司第二家 AEC 大客户收入占比达到 33%，另外公司本季度有一家新的大型客户导入，收入占比达到 14%。

**Marvel：**FY25Q3（24.8~24.10）数据中心业务收入达到 11.01 亿美元，同比+98%，环比+25%，公司宣布与亚马逊深度合作，并达成了长达五年的协议，产品包括定制化芯片、光模块 DSP、AEC DSP、PCIe retimer 等。对于 FY25Q4，公司预计数据中心业务收入环比增长将达到 20~25%。公司维持 FY25、FY26 AI 收入分别为 15、25 亿美元的指引。其中定制化芯片营收分别为 5、10 亿美元，主要来自定制化 AI 芯片。

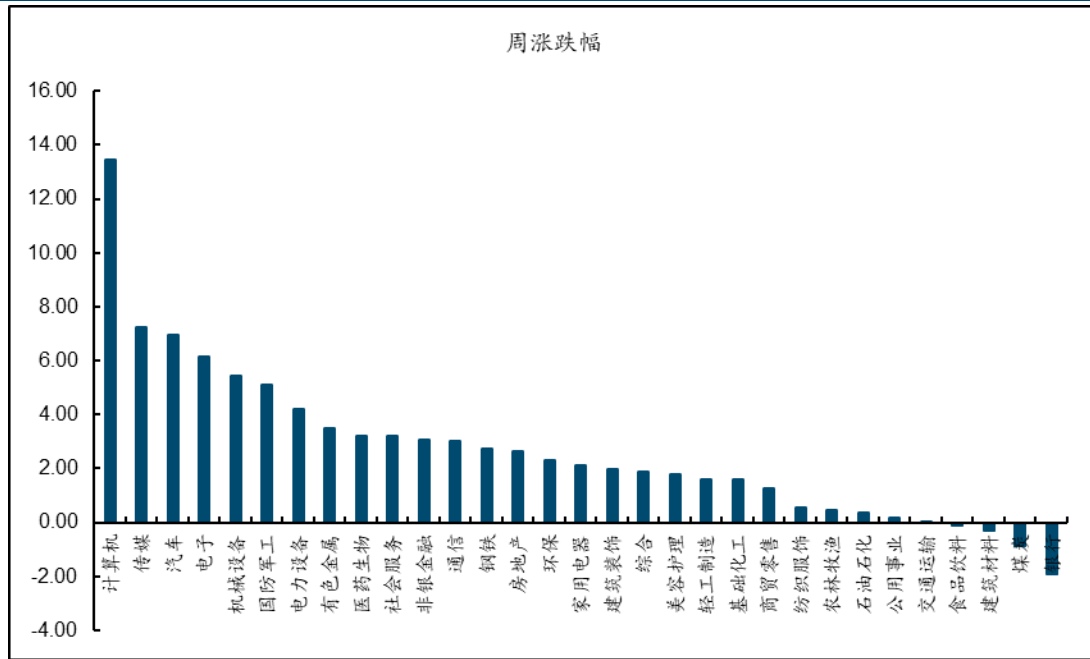
**博通：**FY24（23.11~24.10）AI 营收达到 122 亿美元，同比增长 220%。公司 FY24 网络端收入达到 45 亿美元，同比增长 45%，其中 AI 网络收入占比 76%，同比增长 158%。预计 FY27 公司 AI 网络和 AI ASIC 的 SAM 可以达到 600~900 亿美元。公司下一代 XPU 将采用 3nm 制程，预估将在 FY25H2 对客户发货，公司目前已经有三家 ASIC 客户，将在未来产生收入，同时与其他两家客户开始合作，预计将在 2027 年之前产生收入。

### 三、板块行情回顾

回顾本周行情，参考申万一级行业划分，涨跌幅前三名的行业分别为计算机、传媒、汽车，涨跌幅分别为 13.47%、7.21%、6.93%。涨跌幅后三位为建筑材料、煤炭、银行，涨跌幅分别为-0.30%、-0.86%、-1.92%。本周电子行业涨跌幅为 6.14%。



图表10: 板块周涨跌幅排序 (%) (2025. 2. 5-2025. 2. 7)

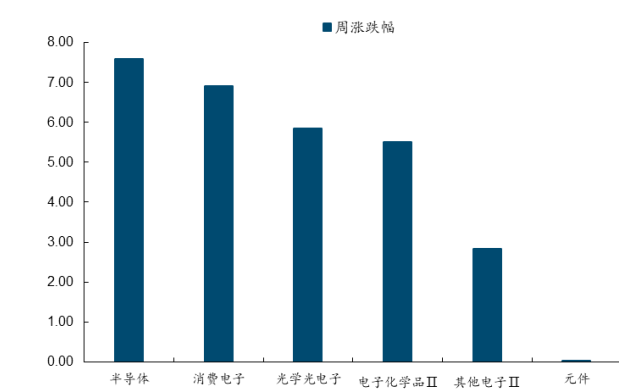


来源: Wind, 国金证券研究所

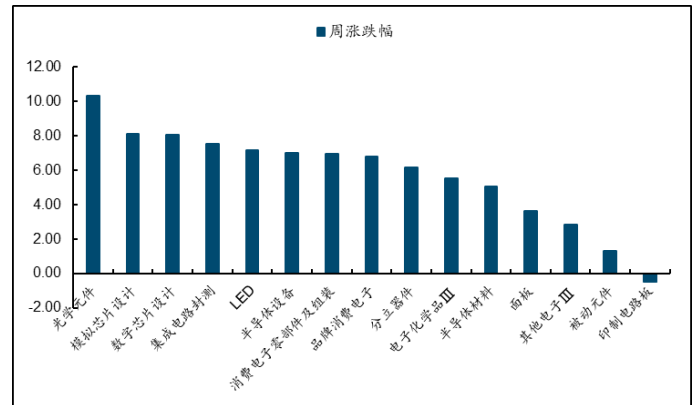
在电子细分板块中,涨跌幅前三大细分板块为光学元件、模拟芯片设计、数字芯片设计,涨跌幅分别为 10.34%、8.11%、8.08%。涨跌幅靠后的三大细分板块为其他电子、被动元件、印制电路板,涨跌幅分别为 2.83%、1.31%、-0.49%。

图表11: 申万二级电子细分板块周涨跌幅 (%) (2025. 2. 5-2025. 2. 7)

图表12: 申万三级电子细分板块周涨跌幅 (%) (2025. 2. 5-2025. 2. 7)



来源: Wind, 国金证券研究所

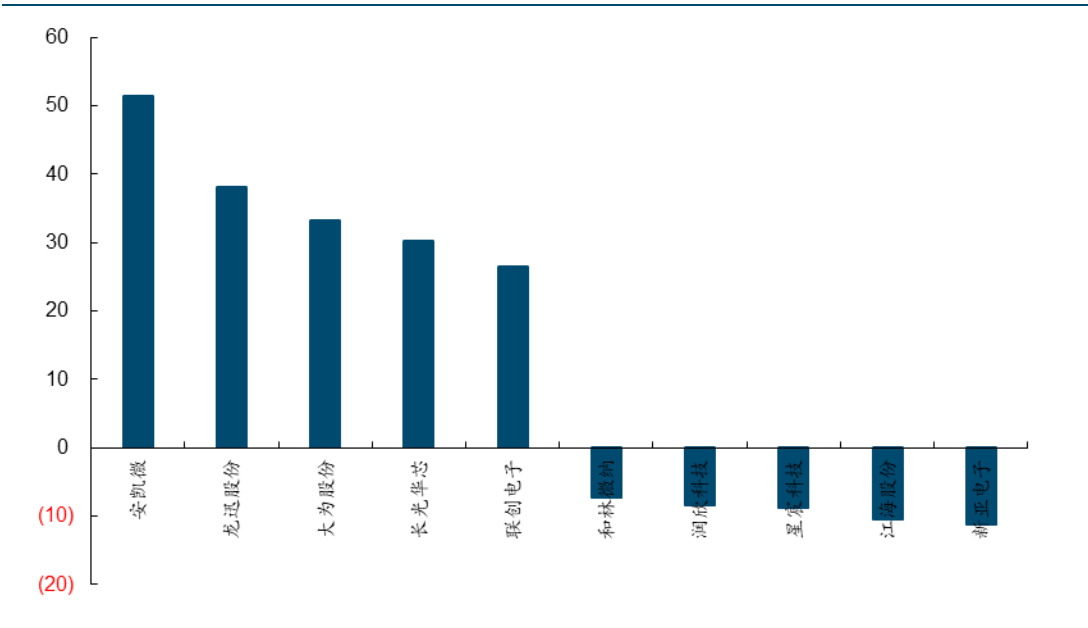


来源: Wind, 国金证券研究所

从个股情况来看,本周安凯微、龙讯股份、大为股份、长光华芯、联创电子为涨幅前五大公司,涨幅分别为 51.32%、38.02%、33.11%、30.29%、26.36%。跌幅前五为新亚电子、江海股份、星宸科技、润欣科技、和林微纳,跌幅分别为 -11.14%、-10.53%、-8.85%、-8.45%、-7.28%。



图表13: 电子板块个股周涨跌幅 (%) (2025. 2. 5-2025. 2. 7)



来源: Wind, 国金证券研究所

#### 四、风险提示

**AIGC 进展不及预期的风险:** 科技巨头公司布局 AI, 存在未来行业竞争进一步加剧、AI 产品不能有效与应用实践相结合的风险。

**外部制裁进一步升级的风险:** 全球范围内的贸易摩擦不断升级, 若美国、日本、荷兰等国出口管制进一步升级, 可能会导致相关企业的核心环节受限。

**终端需求不及预期的风险:** 消费类智能手机创新乏力, 对产业链拉动低于预期, 换机周期较长; 若新能源(电动汽车、风电、光伏、储能)需求不及预期, 电动车销量下滑, 光储装机量不及预期, 可能会对相关公司业绩产生影响。





**行业投资评级的说明：**

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；

增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；

中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；

减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。



**特别声明：**

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于C3级(含C3级)的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 5 楼	地址：北京市东城区建国内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806



【小程序】  
国金证券研究服务



【公众号】  
国金证券研究